

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juli 2008 (24.07.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/087172 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

H05K 3/02 (2006.01) **H05K 1/09** (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/050479

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. Januar 2008 (17.01.2008)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

07100832.0 19. Januar 2007 (19.01.2007) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **BASF SE** [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LOCHTMAN, Rene**
[NL/DE]; M 7, 2, 68161 Mannheim (DE). **KACZUN, Jürgen**
[DE/DE]; In den Backhauswiesen 15, 67157 Wachen-
heim (DE). **WAGNER, Norbert** [DE/DE]; Frankenstr. 6,
67112 Mutterstadt (DE). **PFISTER, Jürgen** [DE/DE]; St.-
Klara-Kloster-Weg 62b, 67346 Speyer (DE).

(74) Anwalt: **ISENBRUCK, Günter**; Isenbruck Bösl
Hörschler Wichmann HuhnTheodor-Heuss-Anlage 12,
68165 Mannheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart):

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart):

ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF STRUCTURED, ELECTRICALLY CONDUCTIVE SURFACES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG STRUKTURIERTER, ELEKTRISCH LEITFÄHIGER OBERFLÄCHEN

(57) Abstract: Disclosed is a method for producing structured, electrically conductive surfaces on a substrate. Said method comprises the following steps: a) a base layer containing particles that can be coated in an electroless manner and/or be electro-plated is structured on the substrate by removing the base layer according to a predefined structure with the help of a laser; b) the surface of the particles that can be coated in an electroless manner and/or be electro-plated is activated; and c) an electrically conductive coating is applied to the structured base layer.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung strukturierter, elektrisch leitfähiger Oberflächen auf einem Substrat, welches folgende Schritte umfasst: a) Strukturieren einer Basisschicht auf dem Substrat, die stromlos und/oder galvanisch beschichtbare Partikel enthält, durch Abtragen der Basisschicht entsprechend einer vorgegebenen Struktur mit einem Laser, b) Aktivieren der Oberfläche der stromlos und/oder galvanisch beschichtbaren Partikel und c) Aufbringen einer elektrisch leitfähigen Beschichtung auf die strukturierte Basisschicht.



WO 2008/087172 A1